

Produktdatenblatt

hm2.0 Federleiste Bauform B25,
Art. Nr. 244-21300-15

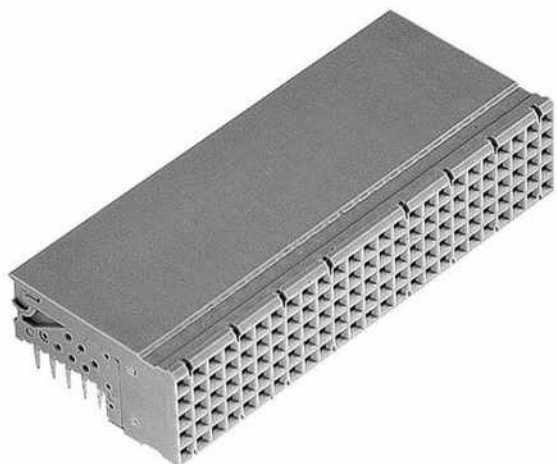


Abbildung ähnlich



Rechtwinklig



Einpresstechnik

- Polzahl 125
- Anschlusslänge 2.9 mm
- für min 1.44 mm Leiterplattendicke
- mit Schirmung
- getestet nach IEC 61076-4-101



» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe hm 2.0

Produktdatenblatt

hm2.0 Federleiste Bauform B25,
Art. Nr. 244-21300-15



Technische Daten

Grundlagen

Spezifikation	IEC 61076-4-101
Gütestufe	2
Anzahl Kontakte	125
Anschluss technik	Einpresstechnik
Anschlusslänge	2.9 mm
Betriebstemperatur	-55°C bis +125°C

Material

Isolierkörper	PBT glasfaserverstärkt, UL 94 V-0
CTI Wert <i>IEC 60112</i>	200
Kontaktmaterial	Bronze

Mechanisch

Rastermaß	2.0 mm
Steckkraft pro Kontakt	Kontakt: max. 0.75 N, Abschirmung: max. 1 N
Ziehkraft pro Kontakt	Kontakt: min. 0.15 N, Abschirmung: min. 0.15 N
Lebensdauer	> 250 Steckzyklen

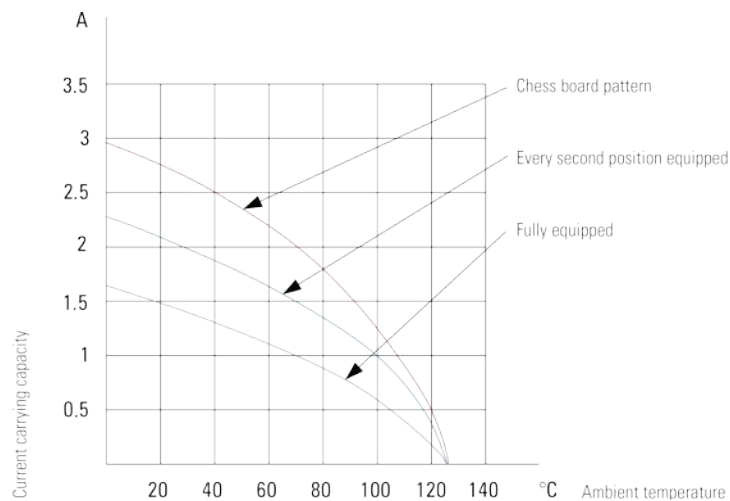
Elektrisch

Betriebsstrom	1.5 A @ +20°C, 1.0 A @ +70°C
Durchgangswiderstand	max. 20 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	≥ 0.6 mm
Isolationswiderstand	min. 10 ⁴ MΩ
Prüfspannung	750 V r.m.s
Datenübertragung	3.125 Gbit/s

Zulassungen / Konformität

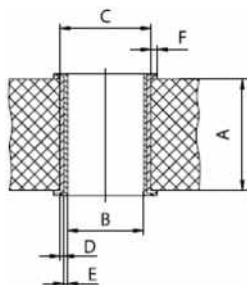
UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

Derating Diagramm



Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Schicht
Nennloch	Ø 0.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 0.60 ±0.05 mm
C Grundbohrung	0.70 ±0.02 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	max. 1.5 µm; chem. Sn Leiterplatten
F Restring	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
Nennloch	Ø 0.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 0.60 ±0.05 mm
C Grundbohrung	0.70 ±0.02 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
F Restring	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
Nennloch	Ø 0.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 0.60 ±0.05 mm
C Grundbohrung	0.70 ±0.02 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	OSP*, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	HAL Sn Leiterplatten
Nennloch	Ø 0.6 mm
A Leiterplattendicke	min 1.44 mm
B Endloch	Ø 0.60 ±0.05 mm
C Grundbohrung	0.70 ±0.02 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	HAL Sn, 5 - 15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Produktdatenblatt

hm2.0 Federleiste Bauform B25,
Art. Nr. 244-21300-15



Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- Andere Kontaktbeschichtung
- Auch in THTR Technik

Zubehör

- » hm2.0 unteres Schirmblech Bauform B25
Artikelnummer 244-21600-1

Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

[» PDF](#)

[» 3D IGES](#)

[» 3D STEP](#)

[» 3D PDF](#)